

過熱検知用ポジスタ[®]

1. 品番の表し方

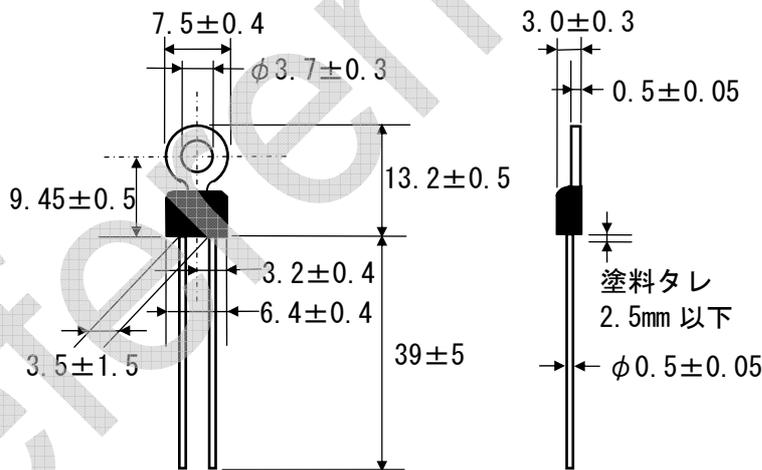
(品番例) PT / FM / 04 / BH / 471 / Q / 2N34 / BS
識別記号 シース 寸法 温度特性 抵抗値 抵抗値許容差 個別仕様 包装仕様コード

2. 形名及び定格

品名	特性	抵抗値		最大電圧	最大電流	外部耐圧	
		25℃	TS-10℃				※ TS
PTFM04BH471Q2N34BS	BH	100Ω以下	330Ω以下/ 50℃	470Ω以上/ 60℃	16VDC.	0.1A	500V DC. 5秒
PTFM04BG471Q2N34BS	BG		330Ω以下/ 60℃	470Ω以上/ 70℃			
PTFM04BF471Q2N34BS	BF		330Ω以下/ 70℃	470Ω以上/ 80℃			
PTFM04BE471Q2N34BS	BE		330Ω以下/ 80℃	470Ω以上/ 90℃			
PTFM04BD471Q2N34BS	BD		330Ω以下/ 90℃	470Ω以上/100℃			
PTFM04BC471Q2N34BS	BC		330Ω以下/100℃	470Ω以上/110℃			
PTFM04BB471Q2N34BS	BB		330Ω以下/110℃	470Ω以上/120℃			
PTFM04BH222Q2N34BS	BH	330Ω以下	1.5KΩ以下/ 50℃	2.2KΩ以上/ 60℃	16VDC.	0.1A	500V DC. 5秒
PTFM04BG222Q2N34BS	BG		1.5KΩ以下/ 60℃	2.2KΩ以上/ 70℃			
PTFM04BF222Q2N34BS	BF		1.5KΩ以下/ 70℃	2.2KΩ以上/ 80℃			
PTFM04BE222Q2N34BS	BE		1.5KΩ以下/ 80℃	2.2KΩ以上/ 90℃			
PTFM04BD222Q2N34BS	BD		1.5KΩ以下/ 90℃	2.2KΩ以上/100℃			
PTFM04BC222Q2N34BS	BC		1.5KΩ以下/100℃	2.2KΩ以上/110℃			
PTFM04BB222Q2N34BS	BB		1.5KΩ以下/110℃	2.2KΩ以上/120℃			

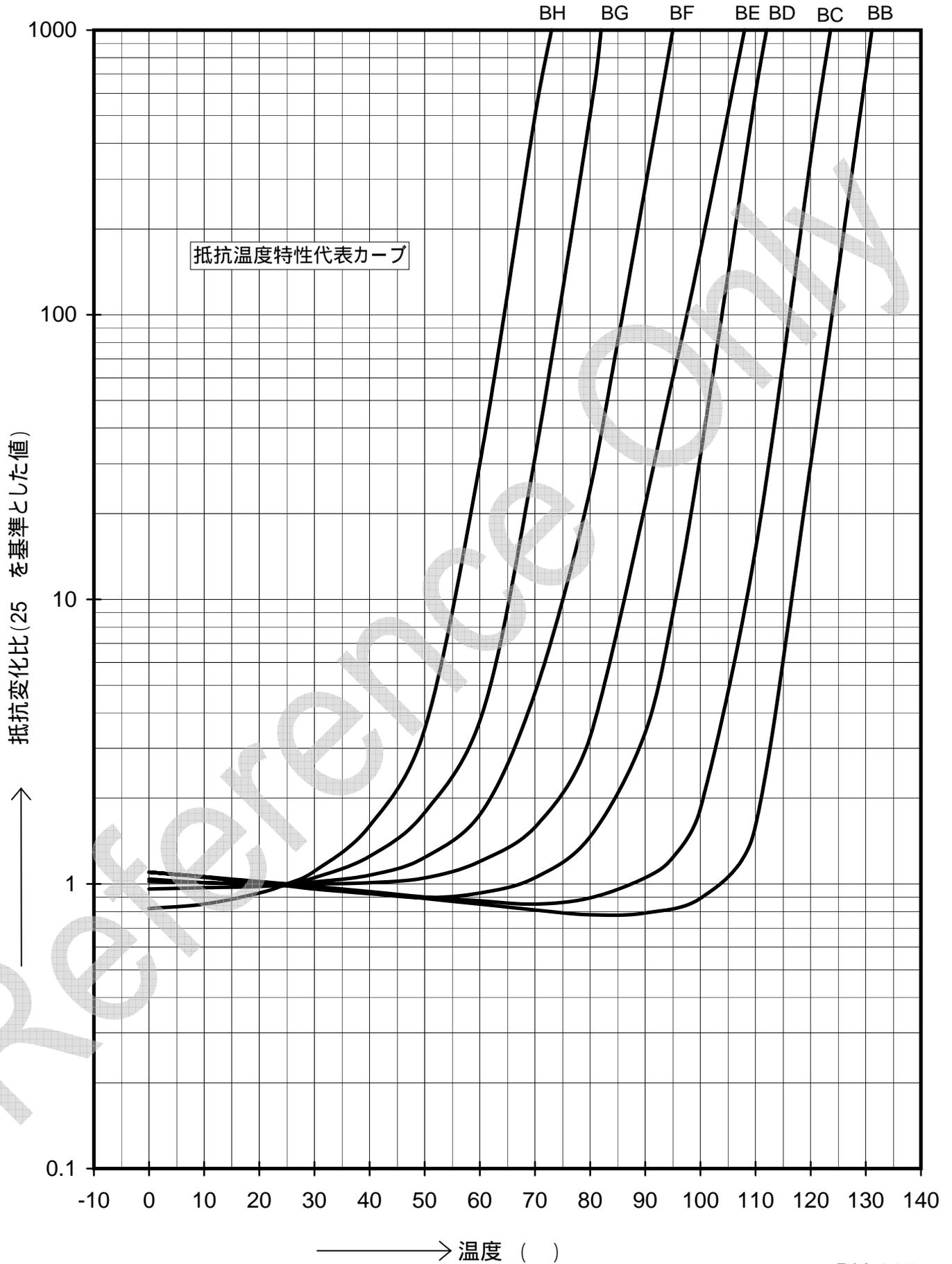
※ TS=検知温度

3. 構造及び寸法 (mm)



4. 製品収納数量 (標準数量)

200pcs./個装袋



BH-007

ご使用にあたっての注意事項

注意

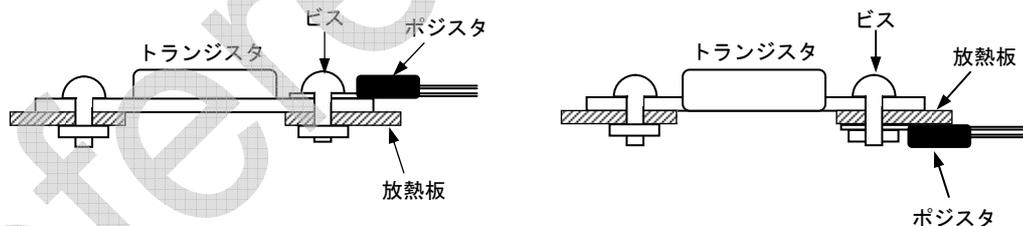
1. 当製品は一般環境（常温、常湿、常圧の室内）で使用されることを前提に設計したものです。したがって、以下に示す環境では特性が劣化し、最悪の場合、故障（or焼損事故）の原因となりますので使用しないで下さい。
 - ① 腐食性、還元性ガス（Cl₂、H₂S、NH₃、SO_x、NO_x 等）
 - ② 揮発性、引火性のあるガス雰囲気
 - ③ 塵埃の多い所
 - ④ 減圧又は加圧された空気中
 - ⑤ 水が直接かかる所や多湿のため結露する恐れのある所
 - ⑥ 塩水、油脂、薬液、有機溶剤にさらされる所
 - ⑦ 振動のはげしい所
 - ⑧ その他①～⑦に準ずる所
2. 用途の限定
当製品について、その故障や誤動作が人命または財産に危害を及ぼす恐れがある等の理由により、高信頼性が要求される以下の用途でのご使用をご検討の場合は、必ず事前に当社までご連絡下さい。
 - ①航空機器
 - ②宇宙機器
 - ③海底機器
 - ④発電所制御機器
 - ⑤医療機器
 - ⑥輸送機器（自動車、列車、船舶等）
 - ⑦交通信号機器
 - ⑧防災／防犯機器
 - ⑨情報処理機器
 - ⑩その他上記機器と同等の機器
3. フェールセーフ機能の付加
当製品に万が一異常や不具合が生じた場合でも、二次災害防止のために完成品に適切なフェールセーフ機能を必ず付加して下さい。

使用上の注意

1. 素子劣化や破損の原因となりますので、規定以上の電圧、電流を印加しないで下さい。
2. 材質劣化や特性劣化の恐れがありますので、規定温度範囲で必ずご使用下さい。
3. ケースと封入樹脂のハガレの原因となりますので、樹脂ケースとリード線との間に、規定(9.8N)以上の力が加わらないように、樹脂ケースを保持した状態でネジの締め付けを行って下さい。
4. リード線と素子との接続部の破壊や素子の破壊及び、ケースと封入樹脂のハガレの恐れがありますので、リード線に規定(9.8N)以上の力が加わらないようにして下さい。
リード線を曲げまたは、切断される場合は素子側のリード線の固定を行なって下さい。
5. 当製品の外装塗装は防水、耐溶剤性を保証するものではありません。特性劣化や漏電などの故障の原因となることがありますので、水/溶剤中や直接水/溶剤がかかる場所では使用しないでください。
6. 特性劣化や素子破壊の恐れがありますので、当製品を接着・樹脂モールド・樹脂コートなどを行う際には、実機にて品質に影響がないことを評価下さい。接着剤・モールド樹脂・コーティング材の塗布量や樹脂厚さの偏りと温度変化により生じるストレスが原因となり、素子にクラックが発生したり、最悪、耐電圧不良などに至る可能性が考えられます。

7. 当製品はリード線とセラミック接続に融点 $221 \pm 5^{\circ}\text{C}$ のはんだを使用しております。接続部の特性劣化の恐れがあるため、当製品に 180°C 以上の温度が加わる加工はしないで下さい。
8. 当製品はセラミック製ですので、落下などによる過度の押圧、衝撃により素子が割れたり、欠けたりしますので取り扱いにご注意下さい。
9. 当製品のリード線をはんだ付けで接続される場合、特性劣化や素子破壊をおこす恐れがありますので、以下の事項に注意下さい。
 - ①非塩素系のフラックスをご使用下さい。（塩素含有率0.2%以下）
 - ②フラックスは素子本体に含浸しないで下さい。
（フラックスははんだ付けするリード線の部分だけに付着させて下さい。）
 - ③予熱は当製品のリード線とセラミック接続のはんだを溶融させない条件を実施下さい。
10. はんだ付け時にリード線引っ張りまたは、股裂き方向に荷重のかからないように取り付けて下さい。
11. 当製品を手はんだ付けする際は、損傷の恐れがありますので、はんだごてを直接樹脂ケース部に触れないようにして、リード線根元から5mm以上、かつ下記条件で行って下さい。
 - ・温度： 360°Cmax .
 - ・時間：4秒max/1端子
 - ・回数：1回
12. はんだ付け性が劣化する恐れがありますので保管には以下の事項に注意下さい。
 - ①保管環境 周囲温度： $-10 \sim 40^{\circ}\text{C}$
相対湿度：75%RH以下（ただし、結露しないこと）
 - ②保管期限 先入れ先出しを行って、納入後6ヶ月以内にご使用下さい。
 - ③開封品の扱い 最小包装を開封後は再シールするか、乾燥剤入り密封容器にて保管して下さい。
 - ④保管場所 直射日光があたったり、特殊ガス（硫黄や塩素等）が存在しない所に保管して下さい。

13. 当製品は、下図の様に温度検知すべき部分に取り付けて使用下さい。



取り付けによって温度検知のバラツキが生じます。取り付け後、実機でご評価下さい。

14. 金属ラグ端子は樹脂ケース部にインサート成形された端子です。金属ラグ端子をネジで締め付けるとき、樹脂ケース部には応力が加わらないようにお取り付け下さい。樹脂ケースが損傷したり、最悪の場合、ケース内の素子が損傷する恐れがあります。
15. 特性劣化の恐れがありますので、接着剤による取り付けは避けて下さい。